

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 29 年 8 月 3 日 (2017.8.3)

【公開番号】特開 2016-29697 (P2016-29697A)
 【公開日】平成 28 年 3 月 3 日 (2016.3.3)
 【年通号数】公開・登録公報 2016-013
 【出願番号】特願 2014-228803 (P2014-228803)
 【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【F I】

| | | |
|---------|------|---|
| H 0 5 K | 3/46 | Z |
| H 0 5 K | 3/46 | B |
| H 0 5 K | 3/46 | N |
| H 0 5 K | 3/46 | Q |
| H 0 5 K | 3/46 | T |

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 6 月 19 日 (2017.6.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記第 2 配線層は、前記第 1 絶縁層の上面に形成された金属バリア膜と前記金属バリア膜上に形成された金属膜とを含むシード層と、前記シード層上に形成された金属層とを有し、

前記第 2 配線層は、

前記金属膜及び前記金属層の側面が、前記粗化面よりも表面粗度の小さい平滑面に形成され、前記金属バリア膜の側面が、前記平滑面と面一となるように、又は前記平滑面よりも内側に後退するように形成された第 1 配線パターンを有することを特徴とする請求項 1 に記載の配線基板。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

前記第 2 配線層は、前記第 1 絶縁層の上面に形成された金属バリア膜と前記金属バリア膜上に形成された金属膜とを含むシード層と、前記シード層上に形成された金属層とを有し、

前記第 2 配線層は、前記金属膜の側面全面及び前記金属層の表面全面が前記粗化面に形成され、前記金属バリア膜の外縁部が前記金属膜及び前記金属層の側面よりも外側に突出された配線パターンのみを有することを特徴とする請求項 1 に記載の配線基板。